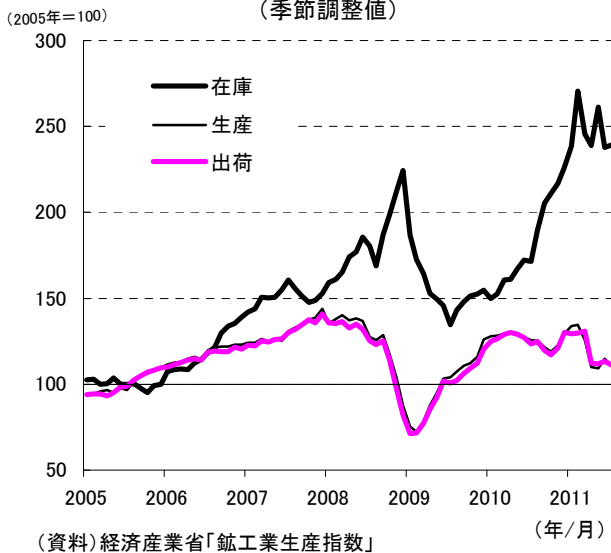


回復が遅れるわが国の電子部品・デバイス生産

- (1) 震災以降、わが国の電子部品・デバイス生産は弱含みが持続（図表1）。生産計画をみても、8～9月も減産の見込み。生産が急回復に転じている自動車・一般機械などとは対照的な動き。
- (2) 品目別にみると、携帯電話などに搭載されるアクティブ型液晶素子（中・小型）など一部の品目では震災前の生産水準を回復しているものの、主要な電子部品・集積回路は低迷しており、震災前の8割程度にとどまる状況（図表2）。
- (3) 在庫が高水準であることを勘案すると、生産弱含みの主因は、供給制約ではなく、需要低迷の公算大。そこで内外別の出荷内訳をみると、国内向け出荷がほぼ横ばいにとどまる一方、輸出向け出荷は2010年初をピークに失速が顕著（図表3）。

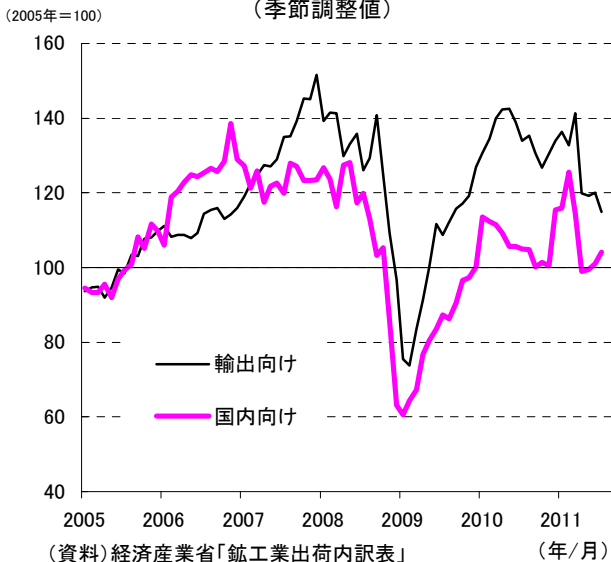
（図表1）電子部品・デバイスの生産・出荷・在庫
（季節調整値）



（図表2）品目別にみた電子部品・デバイスの生産水準
（2011年7月）

品目	ウエイト	生産水準
電子部品・デバイス	1000	82
電子部品	478	85
抵抗器	14	94
固定コンデンサ	54	85
トランス	6	89
水晶振動子・複合部品	24	82
超小形電動機	3	76
通信・電子装置用スイッチ	11	88
コネクタ	47	80
電子回路基板	95	82
磁気テープ	14	84
光ディスク	6	90
スイッチング電源	12	90
PDPモジュール	32	-
アクティブ型液晶素子(大型)	61	81
アクティブ型液晶素子(中・小型)	92	101
パッシブ型液晶素子	8	103
半導体素子	72	75
シリコンダイオード	5	49
整流素子	8	86
トランジスタ	29	74
発光ダイオード	14	82
レーザダイオード	11	59
カプラ・インタラプタ	6	94
集積回路	395	78
線形半導体集積回路	51	81
バイポーラ型半導体集積回路	4	103
モス型半導体集積回路(マイコン)	78	76
モス型半導体集積回路(ロジック)	137	91
モス型半導体集積回路(メモリ)	64	67
モス型半導体集積回路(CCD)	31	84
混成集積回路	29	90
半導体部品	55	91
シリコンウエハ	55	91

（図表3）電子部品・デバイスの出荷内訳
（季節調整値）



(資料) 経済産業省「鉱工業生産指数」

(注) 生産水準は震災前(2011年2月)を100として指数化したもの。

(4) もっとも、電子部品・デバイスの世界市況は、台湾・韓国の生産が増勢を維持するなど、顕著な落ち込みはみられず(図表4)。こうした状況を踏まえると、わが国の電子部品・デバイスは“ひとり負け”の様相。

(5) この背景として、円高による輸出競争力の低下を指摘可能(図表5)。差別化の図れていない汎用品を中心に輸出が伸び悩んだ結果、在庫が積み上がり、生産へのマイナス圧力として作用している公算大。

(6) 今後を展望しても、円高地合いが続くと予想されることに加え、世界経済の減速懸念も強まっているため、電子部品・デバイス生産の回復は期待薄。ちなみに、半導体生産に対し先行性を持つといわれる半導体製造装置のBBレシオ(受注額/出荷額)は、2011年入り後、好不調の目安である1.00を割り込んで推移しており、生産活動の低迷を示唆(図表6)。

